

収益改善に向けた体質改革プログラム

2009年 1月29日

株式会社 **東芝**

代表執行役社長 西田 厚聰

注意事項

この資料には、当社及び当社グループの将来についての計画や戦略、業績に関する予想及び見通しの記述が含まれています。

これらの記述は、過去の事実ではなく、当社が現時点で把握可能な情報から判断した仮定及び所信にもとづく見込みです。

また、多様なリスクや不確実性(経済動向、エレクトロニクス業界における激しい競争、市場需要、為替レート、税制や諸制度等がありますが、これに限りません。)を含んでいます。そのため、実際の業績は当社の見込みとは異なる可能性があることをご承知おきください。

➤ I. 体質改革プログラム

II. 課題事業における事業構造改革

III. 体質強化に向けた全社施策

IV. 成長事業への集中と選択の加速

V. 最後に

2009年度の収益改善に向けて

2008年度は経営環境が急激に悪化

2009年度も厳しい経営環境が継続

- 売上規模が2008年度レベルでも利益確保が可能な収益体質へ転換
- 市況回復時に素早く対応できる事業体制の構築

体質改革プログラムの実行

2009年度の黒字化を実現

2009年度に向けた「体質改革プログラムの実行」

1. 課題事業における事業構造改革

- 半導体事業の構造改革
- 液晶事業の構造改革
- その他課題事業(デジタルプロダクツ、家電等)についても同時に検討

2. 体質強化に向けた全社施策

- 徹底した固定費削減
対08年度 3,000億円削減
- 利益造出に向けた施策(コスト競争力強化・海外事業拡大等)

3. 成長事業への集中と選択の加速

- 社会インフラ事業へ経営資源をシフト
- 新規事業の加速(環境・エネルギー分野等)

I. 体質改革プログラム

➤ II. 課題事業における事業構造改革

III. 体質強化に向けた全社施策

IV. 成長事業への集中と選択の加速

V. 最後に

半導体事業の構造改革（事業環境）

市場環境

- デジタル民生機器・自動車等の販売不振による需要激減
- 急激かつ継続的な価格下落

業界動向と当社の状況

- ディスクリット：安定市場であるが優位化要素の明確化が課題
参入市場での位置づけはトップレベルを維持
- システムLSI：多様・多数のプレーヤーによる激しい競争
当社も競争環境の中で収益悪化
- NAND型フラッシュメモリ：
安定的供給力のあるメーカーは、既に限定的
勝ち残りを懸けて、強化策を継続

事業毎の特徴に合わせた抜本的構造改革を実施

半導体事業の構造改革(ディスクリート、システムLSI)

ディスクリート事業

- パワーデバイス、オプトデバイスを中心とする販売力強化
- 後工程製造体制：国内拠点再編と海外展開加速

システムLSI事業

- アナログ、イメージセンサ、ワイヤレス、デジタルテレビ用LSIに注力
- 開発リードタイム半減
- 前工程拠点再編：北九州工場から大分工場へのアナログIC移管
- 後工程製造：海外展開推進



自らの体質改革に加え、業界再編を視野に入れ
分社化も含めた抜本的構造改革を検討

半導体事業の構造改革(NAND型フラッシュメモリ)

● 在庫調整の進行による2009年後半以降の需要回復に向け準備

● SSD*1事業の拡大

- サーバー市場への参入により事業拡大
- HDDと併せてストレージデバイス事業として強化

● 新棟建設計画は延期

- 四日市地区:着工時期を2009年から2010年を目処に延期
- 北上地区 :市場動向に応じ投資時期等を判断

● 生産能力向上

- サンディスク社*2との製造合併会社からの生産設備の一部買取
- 微細化
 - 43nm*3品 2009年3月末までに90%以上切替
 - 32nm品 2009年9月出荷開始予定



*1:SSD :Solid State Drive

*2:サンディスク社:米国 サンディスク・コーポレーション

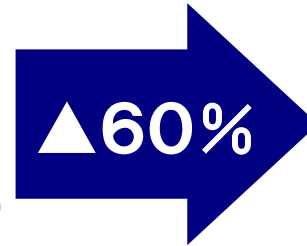
*3:nm: ナノメートル、 10^{-9} m

半導体事業の構造改革(共通施策)

固定費削減

● 設備投資

2008年度見込
2,300億円
 (対当初計画 ▲1,370億円)



2009年度計画
1,000億円未満

● 製造拠点再編

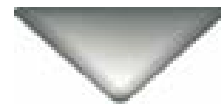
- ・ システムLSI: 北九州工場から大分工場へのアナログIC移管
- ・ システムLSI・ディスクリート: 国内後工程の生産縮小／海外増強

● 研究開発費の運用効率改善(研究開発費 対08年度20%削減)

- ・ 開発アイテム絞込み、開発効率向上

● 人的施策(概ね2008年度末までに実施)

- ・ 帰休の実施
- ・ 有期限雇用の削減
- ・ 人員の再配置
(2009年度に実施)



固定費:対08年度15%以上削減

液晶事業の構造改革

● 集中と選択の徹底

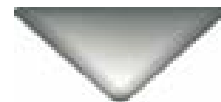
- アモルファス製品の大幅縮小と低温ポリシリコン製品への資源集中による採算化実現
- 今後拡大が期待される有機EL商品の開発強化
- 生産能力増強投資の抑制

● 生産拠点の再編

- 魚津工場、深谷工場の不採算製造ラインの停止、縮小

● 人的施策

- 帰休の実施
- 有期限雇用の削減
- 人員の再配置



固定費:対08年度25%以上削減

I. 体質改革プログラム

II. 課題事業における事業構造改革

➤ III. 体質強化に向けた全社施策

IV. 成長事業への集中と選択の加速

V. 最後に

体質強化に向けた全社施策

徹底した固定費削減

固定費総額：対08年度 3,000億円削減

- 研究開発費の抑制
- 設備投資の抑制
- 人的施策
- 拠点統廃合
- 経費削減

利益造出に向けた基盤の強化

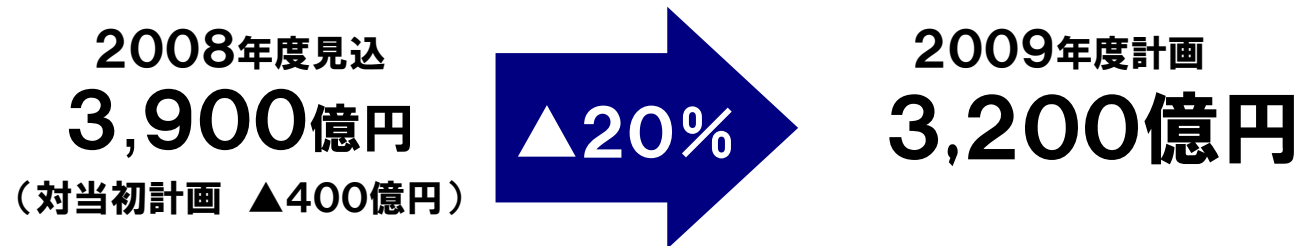
原価低減によるコスト競争力の強化

- 調達力の強化
- 開発・製造力の強化

海外事業の拡大

研究開発費の抑制

研究開発費総額



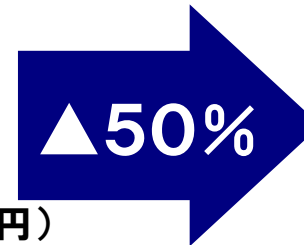
研究開発方針

- **開発テーマの厳選による集中と選択**
 - **環境・エネルギー分野、データストレージ分野等へ重点投資**
- **開発効率向上**
 - **プラットフォーム化の推進による開発資産の共有化**
 - **システム開発における海外リソースの有効活用**

設備投資の抑制

**注力事業への戦略的
資源配分の継続と
投資内容の厳選**

2008年度見込
4,550億円
(対当初計画 ▲2,000億円)



2009年度計画
2,300億円

戦略投資分野

- 電力・産業システム分野
- 新規事業分野
 - 新型二次電池(SCiB™)、小型燃料電池(DMFC*)、新照明システム等

*DMFC:Direct Methanol Fuel Cell ダイレクトメタノール型燃料電池

厳選投資分野

- 半導体事業：微細化による競争力強化のための投資に注力
 - NAND型フラッシュメモリ：新規設備投資を抑制
 - 四日市地区：着工時期を2009年から2010年を目処に延期
 - 北上地区：市場動向に応じ投資時期等を判断
- 液晶事業：能力増強投資の抑制

人的施策

正規従業員は雇用を維持

- 強化事業部門への人員シフト
- 社外委託業務や有期限雇用業務の取込

ワークシェアリング実施（半導体事業、液晶事業）

- 勤務形態の見直しによる時間外勤務削減
- 帰休の実施
 - ・ 雇用の場の確保

事業別の計画に基づく人員の見直し

- 半導体事業、液晶事業を中心に人員規模適正化
 - ・ 有期限雇用人員:4,500人減
- 有期限雇用社員を正規従業員に登用
 - ・ 社会インフラ事業を中心に約500人(2008年度)

利益造出に向けた基盤の強化

徹底した原価低減によるコスト競争力の強化

i cube活動の加速による生産性向上 対08年度15%改善

- 調達力の強化
 - ・ 全体最適化によるグループ総合力の発揮
- 開発・製造力の強化
 - ・ 上流段階からの品質・コストの作り込み
 - ・ スループットアップ改善、リードタイム短縮

海外事業の拡大

海外売上高比率60%の早期実現

- 社会インフラ事業におけるグローバル展開加速
- 新興国市場への注力

- I. 体質改革プログラム
- II. 課題事業における事業構造改革
- III. 体質強化に向けた全社施策
- IV. 成長事業への集中と選択の加速**
- V. 最後に

社会インフラ事業の強化(原子力事業)

世界規模で新設プラント需要は引き続き堅調

- 米国:32基以上の新設計画・・・17サイト26基COL*¹申請済
- 中国:2020年までに50基の新設計画(100万kW級相当/基)
- その他、英国、フィンランド、インド、東南アジア等で新設計画



AP1000*²:米国、中国で計10基を受注済み

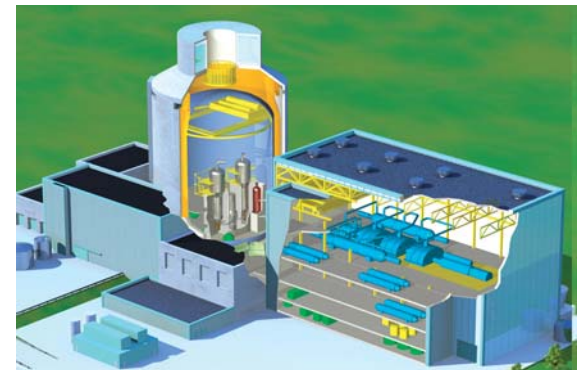
ABWR*³ :米国サウステキサスプロジェクト(2基)へ参画中

2015年までに全世界で
39基の受注を見込む

*1: COL:Combined Construction and Operation License (建設・運転一括許可)

*2: AP1000:次世代型加圧水型原子炉

*3: ABWR:Advanced Boiling Water Reactor(改良型沸騰水型原子炉)



最新型加圧水型軽水炉「AP1000」

社会インフラ事業の強化(原子力事業<続き>)

規模拡大に対応した体制強化

- 磯子エンジニアリングセンターの拡張
- 京浜事業所の製造設備増強
- アライアンス、M&A等によりエンジニアリング、建設・保守サービス力を強化

燃料ビジネス(フロントエンド・バックエンド)への事業拡大

- カザフスタン カザトムプロム社との戦略的提携
- ロシア アトムエネルゴプロム社との相互協力
- その他

今後とも積極的に他社とのアライアンス含め体制強化、
事業拡大を目指す

社会インフラ事業の強化(グローバル化の加速)

火力・水力事業

グローバルな需要増加に対応した拠点の拡充

- **インド:火力発電設備の製造・販売拠点をJSWグループ*¹との合併で設立(2008年9月)**
- **中国:水力発電設備の製造・販売拠点の製造能力を増強(2008年11月)**

送変電・配電機器(T&D)事業

新興国市場の需要増加に対応した製造・販売体制の強化

- **中南米:ブラジル CCES社*²の買収(2008年12月)**
- **中国:変電機器の製造拠点の製造能力増強**

*1 JSWグループ:ジンダル・サウス・ウェスト グループ

*2 CCES社:Camargo Correa Equipamentos e Sistemas社

社会インフラ事業の強化(グローバル化の加速<続き>)

産業システム事業

世界各国での法制化による高効率モータへのシフト需要に対応したグローバル生産体制の強化

- ベトナムに製造・販売拠点を設立(2008年12月)

昇降機事業

中国およびアジアを中心に規模拡大に向けた販売・エンジニアリング体制強化

- シュバリエ インターナショナル社(香港)との資本提携(2008年12月合意)

医用システム事業

テクノロジーリーダーシップの強化に向けたグローバルR&D体制の強化

- ベルギー バルコ社から医療用3次元画像処理事業部門の買収(2008年11月契約)

新規事業の育成・強化

新型二次電池事業(SCiB™)

- 産業用途、車載用途のリチウムイオン電池の大幅な需要拡大
(2015年度の世界市場規模:約1.7兆円を想定)



⇒ 将来の需要拡大に備え第二量産工場新設を計画

小型燃料電池事業(DMFC)

- 外付け充電器の販売開始(2008年度中)
- 携帯電話用(パック)、
PC用を商品化(2009年度中を目標)



新規事業の育成・強化<続き>

太陽光発電システム事業

- メガソーラ等の電力・産業用大規模システムの需要拡大
(2015年度の世界市場規模:約2.2兆円を想定)
- インバータ、SCiB™、エンジニアリング力等の総合力を活かし
グローバルで規模拡大 ⇒統括組織を設置(2009年1月)

CCS*1事業

*1: CCS:Carbon dioxide Capture and Storage

- 火力発電所などからのCO2排出量削減対策として期待大
⇒ CO2分離・回収技術研究のためのパイロットプラント建設を決定
(2008年12月)

新照明システム事業

- 低環境負荷のLED商品ラインナップ拡充
- グローバル規模拡大に向け欧米に営業拠点
(2009年4月から順次展開)



I. 体質改革プログラム

II. 課題事業における事業構造改革

III. 体質強化に向けた全社施策

IV. 成長事業への集中と選択の加速

➤ V. 最後に

**市況回復を待つのではなく
この逆境に打ち克つべく
将来を見据えて判断し決断したこと
(=収益改善のための諸施策)を
あらゆる困難を乗り越えて
完全実行してまいります。**

END